

# 2023年度 第4四半期 決算説明資料

2024.4.25

## 将来の見通しに関する注意事項

このプレゼンテーションに掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。

実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

実際の業績に影響を与える重要な要素には、世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

売上高

3,075 億円

前年 2,841 億円

過去最高

GP率

67.8 %

前年 64.9%

過去最高

営業利益

1,214 億円

前年 1,104 億円

過去最高

利益率

39.5 %

前年 38.9 %

過去最高

CAPEX

165 億円

前年 149億円

R&D

273 億円

前年 224億円

総資産

5,560 億円

前年 4,687億円

4年累計経常利益率

37.0 %

前年 34.4 %

FCF

811 億円

前年 687 億円

ROE

22.4 %

前年 25.9 %

EPS

777 .29 円

前年 765.47 円

年間配当

1株あたり

307 円

前年 916円

過去最高 ※

※2023年4月1日付で株式分割を実施（3分割）  
前年度期首に当該分割したと仮定すると前年実績は305円

(単位:百万円)	FY2023	FY2023	QoQ		FY2022	YoY	
	4Q	3Q	差額	(%)	4Q	差額	(%)
売上高	104,299	76,995	27,304	35.5%	79,015	25,284	32.0%
売上総利益	71,324	52,654	18,670	35.5%	51,224	20,101	39.2%
GP率	68.4%	68.4%	0.0p	-	64.8%	3.6p	-
販売管理費	25,197	22,300	2,896	13.0%	19,939	5,258	26.4%
営業利益	46,127	30,353	15,774	52.0%	31,284	14,842	47.4%
経常利益	46,666	29,449	17,217	58.5%	32,150	14,516	45.2%
経常利益率	44.7%	38.2%	6.5p	-	40.7%	4.0p	-
税前利益	46,453	21,876	24,577	112.3%	32,726	13,726	41.9%
純利益	35,425	16,071	19,354	120.4%	25,671	9,753	38.0%

売上高: YoY QoQ とともに装置検収の進捗により増加

GP率: YoY 高付加価値製品や改善活動、為替影響等が寄与し上昇

販売管理費: YoY 主に人件費や研究開発費が増加

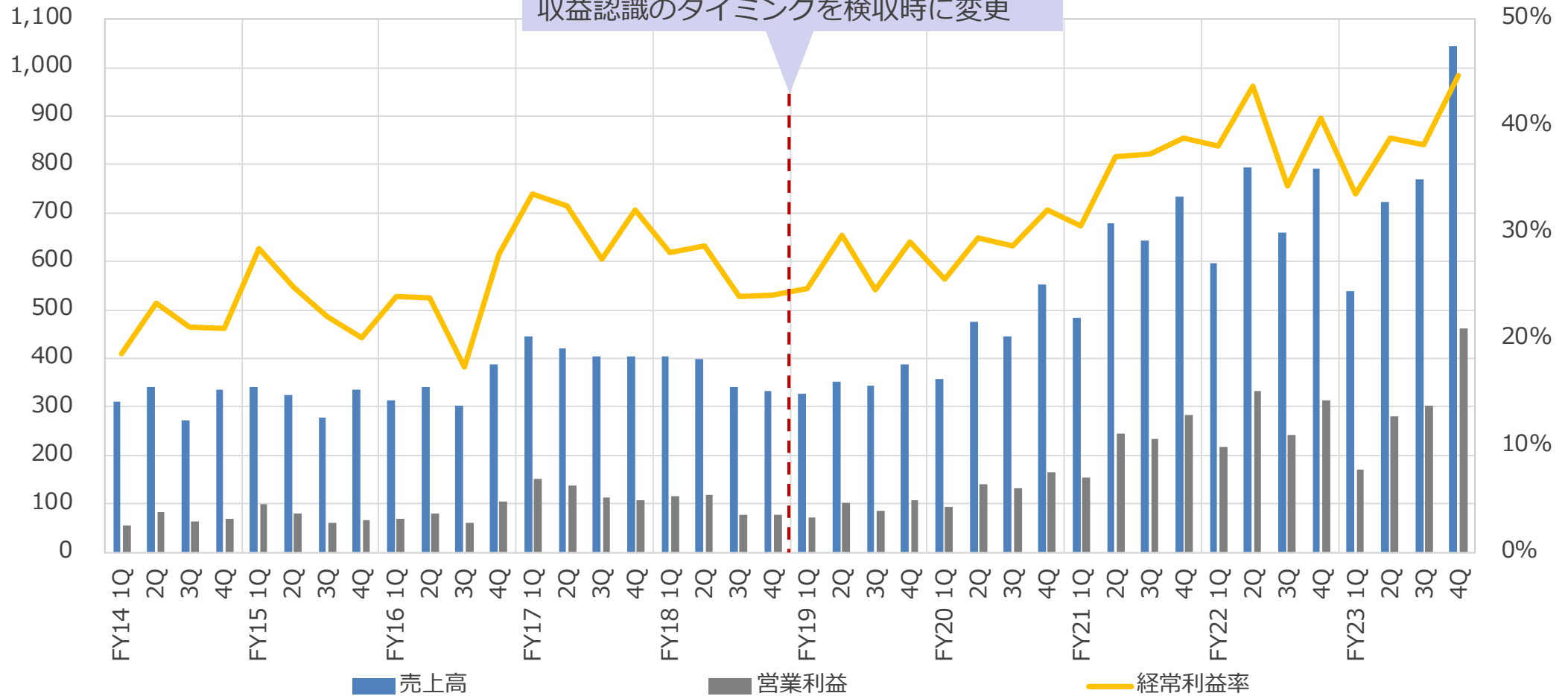
(単位：百万円)	FY2023 Full Year	FY2022 Full Year	YoY	
			差額	(%)
売上高	307,554	284,135	23,419	8.2%
売上総利益	208,642	184,506	24,135	13.1%
GP率	67.8%	64.9%	2.9p	-
販売管理費	87,151	74,093	13,057	17.6%
営業利益	121,490	110,413	11,078	10.0%
経常利益	122,393	112,338	10,054	9.0%
経常利益率	39.8%	39.5%	0.3p	-
税前利益	114,576	112,785	1,790	1.6%
純利益	84,205	82,891	1,314	1.6%

売上高： 高水準の製品出荷を背景に検収売上が伸長（過去最高）

GP率： 主に為替影響により上昇

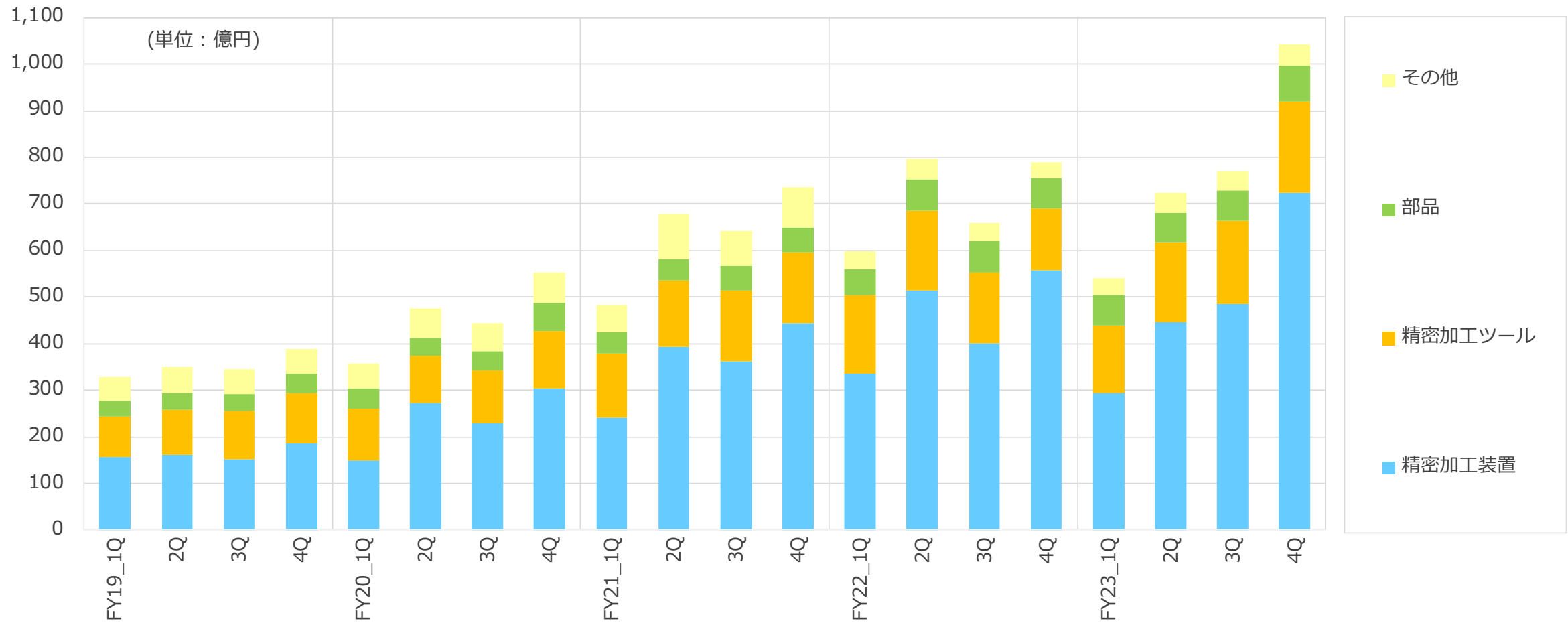
販売管理費： 主に人件費や研究開発費が増加

(単位：億円)



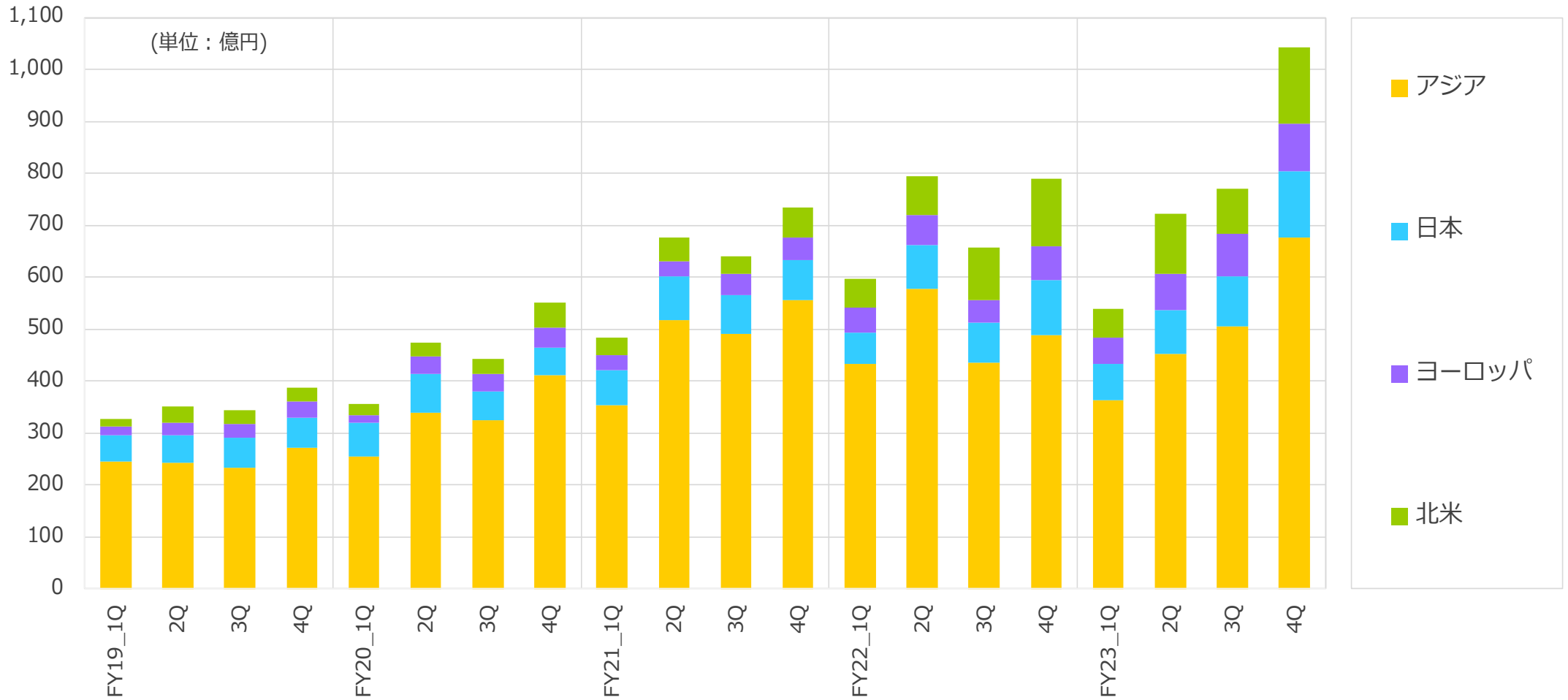
売上高は四半期ベースで初めて1,000億円超を記録  
 (FY23\_4Q 営業利益率44.2% 経常利益率44.7% 純利益率34.0%)

# 製品群別売上高 四半期推移

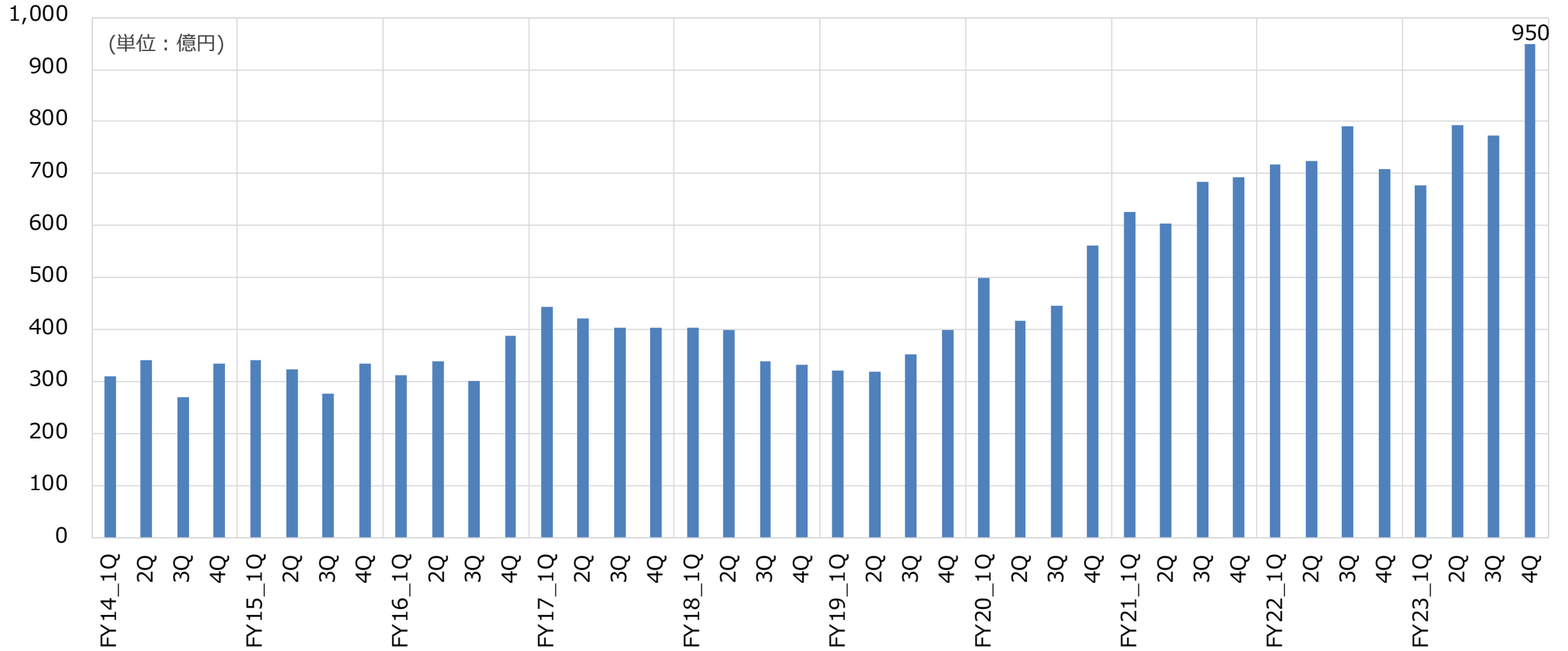


※構成比数値は、Webサイト「補足情報」に記載

# 地域別売上高 四半期推移



FY23\_4Q 海外売上高比率 87.9%

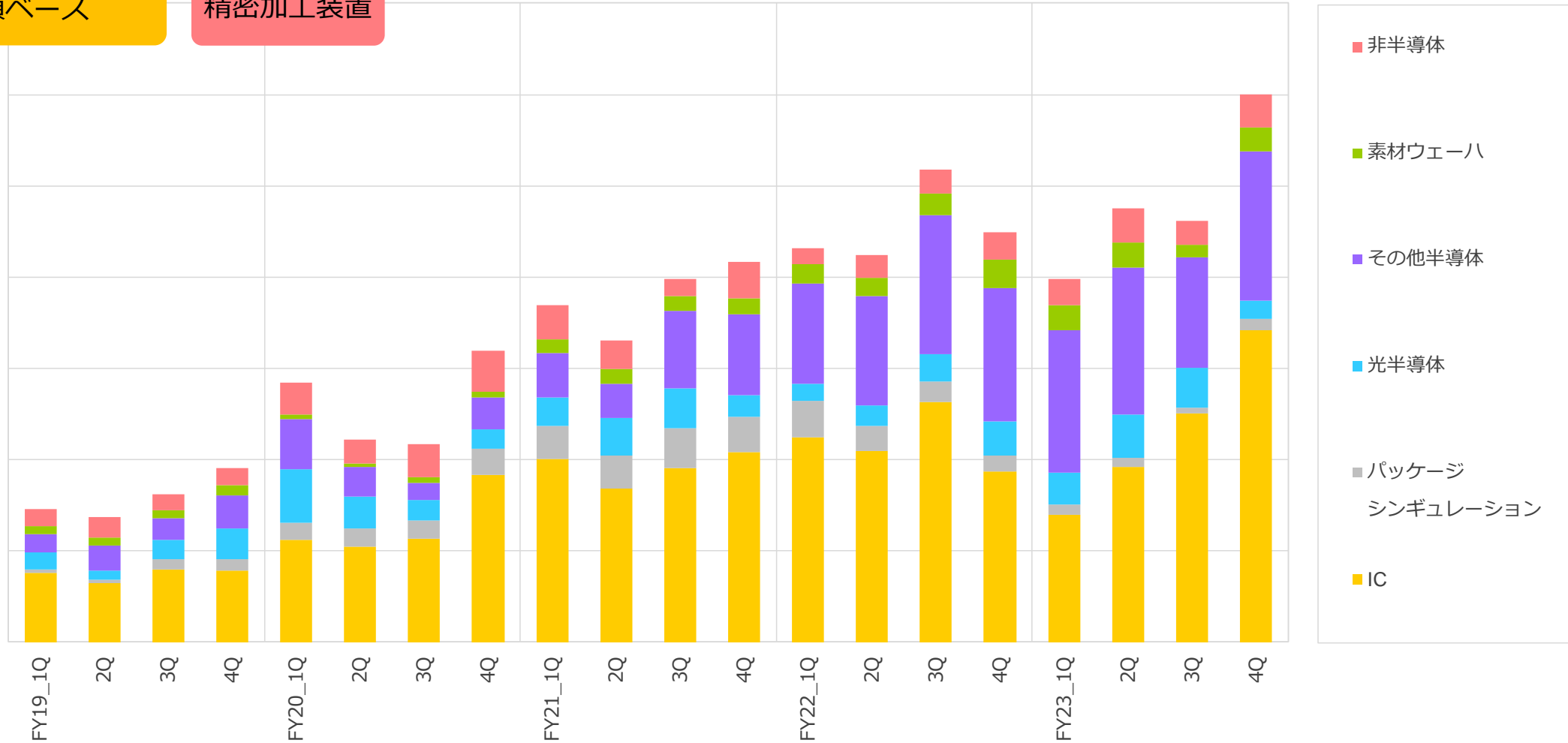


FY23\_4Q 出荷額 約950億円



出荷額ベース

精密加工装置

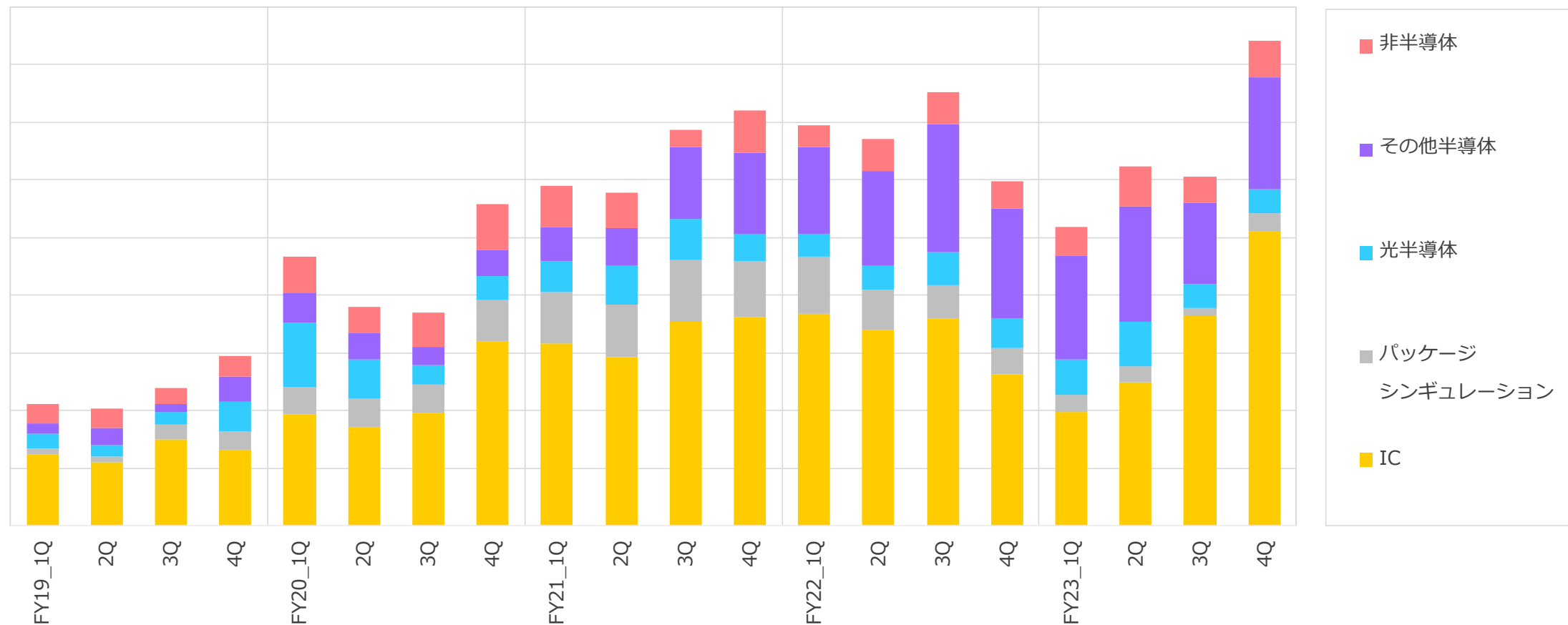


QoQ  
YoY

生成AI向けのICとパワー半導体（その他半導体）向けの増加が全体を押し上げた  
生成AI需要の拡大によりIC向けが大幅増となった

出荷額ベース

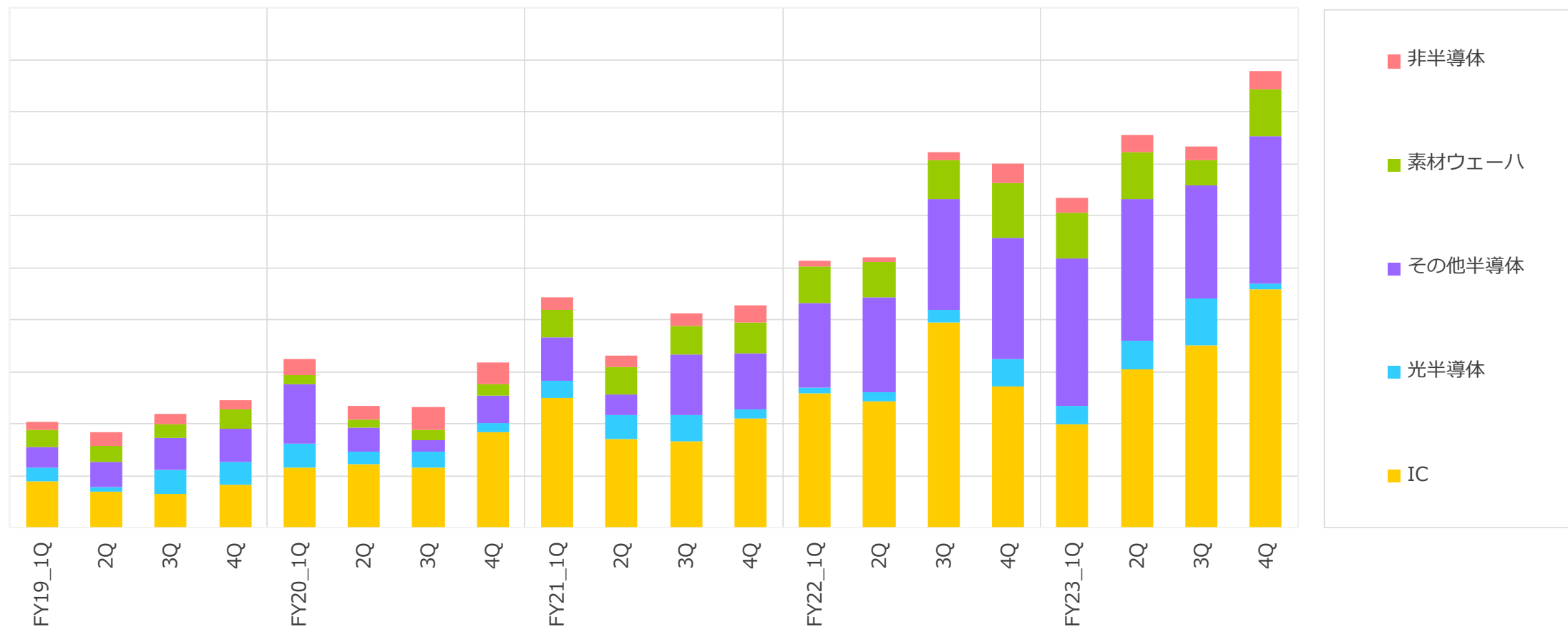
ダイサ



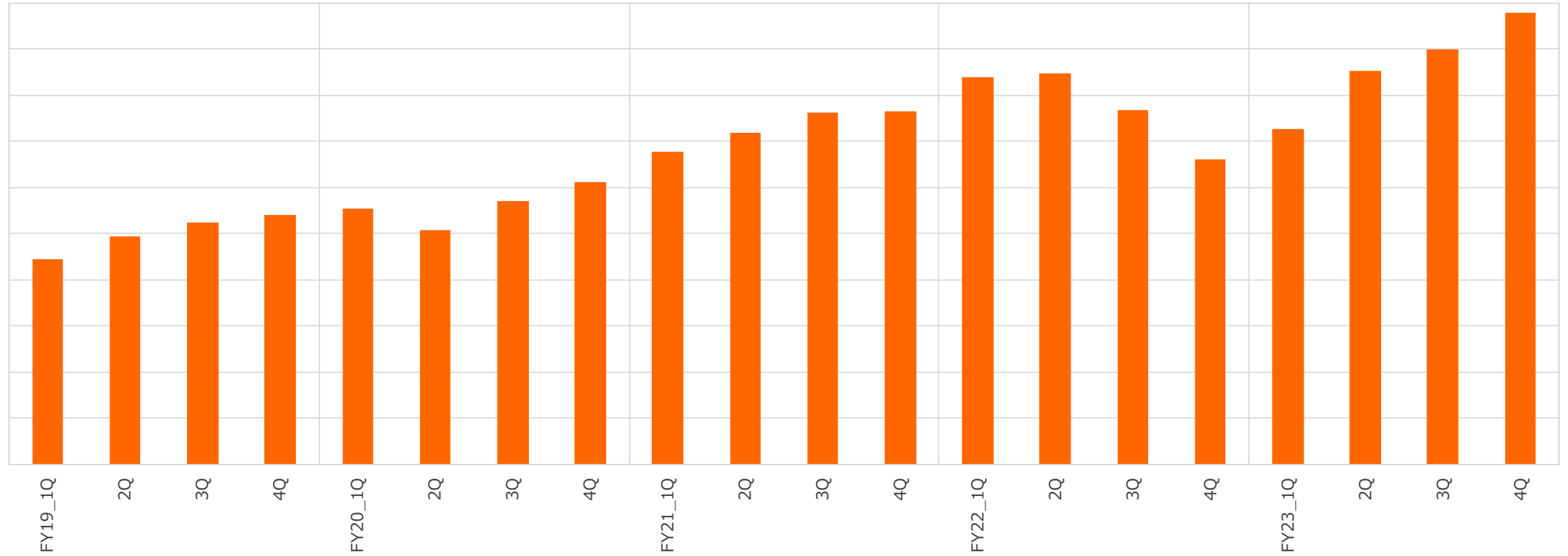
QoQ 生成AI向けのICとパワー半導体（その他半導体）向けの増加が全体を押し上げた  
 YoY 生成AI需要の拡大によりIC向けが大幅増となった

出荷額ベース

グラインダ



QoQ 生成AI向けのICとパワー半導体（その他半導体）向けの増加が全体を押し上げた  
 YoY 生成AI需要の拡大によりIC向けが大幅増となった



精密加工ツール（消耗品）の出荷は堅調に推移  
顧客の設備稼働率の上昇等を背景に過去最高を更新

(単位：百万円)	FY2023 4Q	FY2023 3Q	差額
現金及び預金	215,486	172,222	43,264
受取手形・売掛金	46,807	38,860	7,947
棚卸資産	114,992	113,734	1,257
流動資産	386,945	333,107	53,839
有形固定資産	147,451	145,364	2,086
固定資産	169,112	162,981	6,130
総資産	556,058	496,088	59,969
流動負債	148,715	125,613	23,102
固定負債	781	819	-38
負債合計	149,497	126,433	23,064
純資産	406,560	369,655	36,905
負債純資産合計	556,058	496,088	59,969
自己資本比率	72.9%	74.3%	-1.4p

総資産：主に現預金や棚卸資産が増加

負債：主に賞与引当金や未払法人税等が増加

純資産：主に利益剰余金が増加

(単位：百万円)	FY2023 Full Year	FY2022 Full Year	差額
営業キャッシュ・フロー	97,524	81,783	15,741
税前当期利益	114,576	112,785	1,790
減価償却	11,031	10,371	659
売上債権の増減	-2,650	-1,398	-1,252
棚卸資産の増減	-22,226	-21,682	-543
仕入債務の増減	9,591	-2,364	11,955
法人税支払い	-31,600	-33,463	1,863
その他営業CF	18,803	17,535	1,268
投資キャッシュ・フロー	-16,403	-13,077	-3,327
有形固定資産の取得	-16,140	-14,208	-1,931
フリー・キャッシュ・フロー	81,120	68,706	12,415
財務キャッシュ・フロー	-30,938	-32,090	1,152
配当金支払い	-31,115	-32,154	1,038
現金同等物増減	52,433	37,281	15,151
期首残高	163,053	125,771	37,282
期末残高	215,486	163,053	52,433

●営業CF・・・約975億円 資金増加  
主に税前利益による資金増加

●投資CF・・・約164億円 資金減少  
主に有形固定資産の取得によるもの

●フリー・キャッシュ・フロー  
約811億円の資金増加

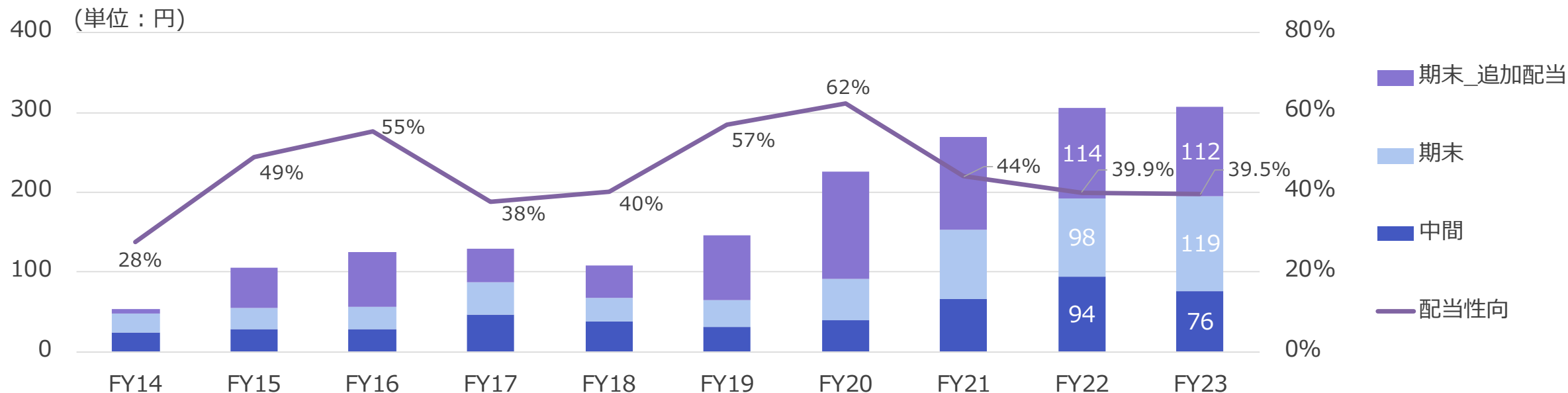
●財務CF・・・約309億円 資金減少  
主に配当金の支払い

→ 3月末の現金残高 約2,154億円

## 【配当方針】

1. 期末、中間の年2回、連結半期純利益の25%を配当する
2. 安定配当として半期10円（年間20円）を維持。ただし3期連続で連結純損失の場合を除く
3. 年度末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額(\*)を超過した場合は、上記1.に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乗せする（追加配当）

\*技術購入予備費（技術特許購入、ベンチャーへの出資等）および設備拡張資金、有利子負債返済資金など



FY23 実績 中間：76円 期末：231円 年間：307円（過去最高）

※2023年4月1日付けで普通株式1株につき3株の割合で株式分割を実施  
 (FY22以前の配当推移は当該株式分割が行われたと仮定して記載)





(単位：億円)

今回予想

	FY23 1Q	2Q	3Q	4Q	FY24 1Q
売上高	540	723	770	1,043	753
営業利益	170	280	304	461	271
経常利益	182	281	294	467	272
純利益	127	200	161	354	189
営業利益率	31.5%	38.8%	39.4%	44.2%	36.0%
経常利益率	33.7%	38.9%	38.2%	44.7%	36.1%
純利益率	23.5%	27.7%	20.9%	34.0%	25.1%
出荷額	678	794	773	950	935

※億円未満 四捨五入

想定為替レート 1Q (4-6月期)  
為替感応度 (年換算)

US\$ : 145円  
US\$ : 約13億円

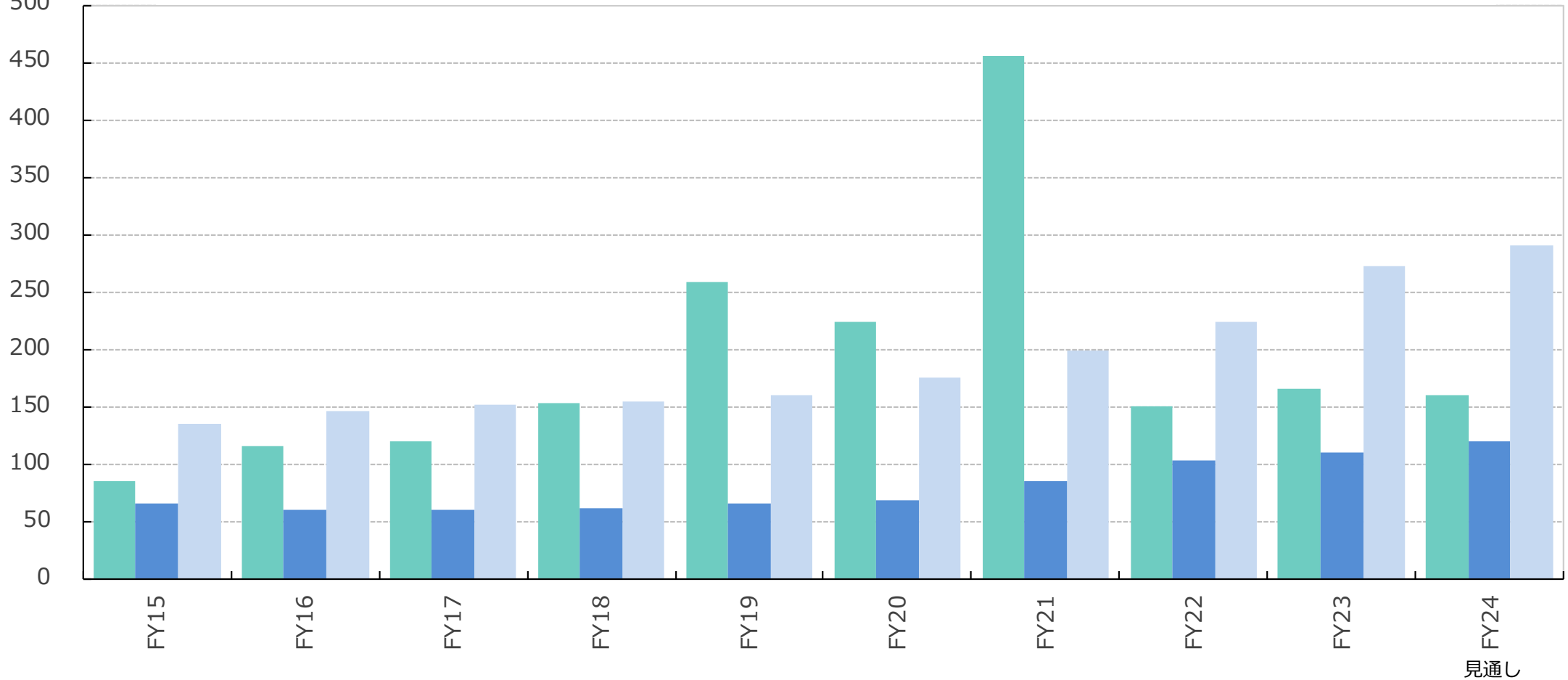
Euro : 155円  
Euro : 約9千万円

出荷額ベース

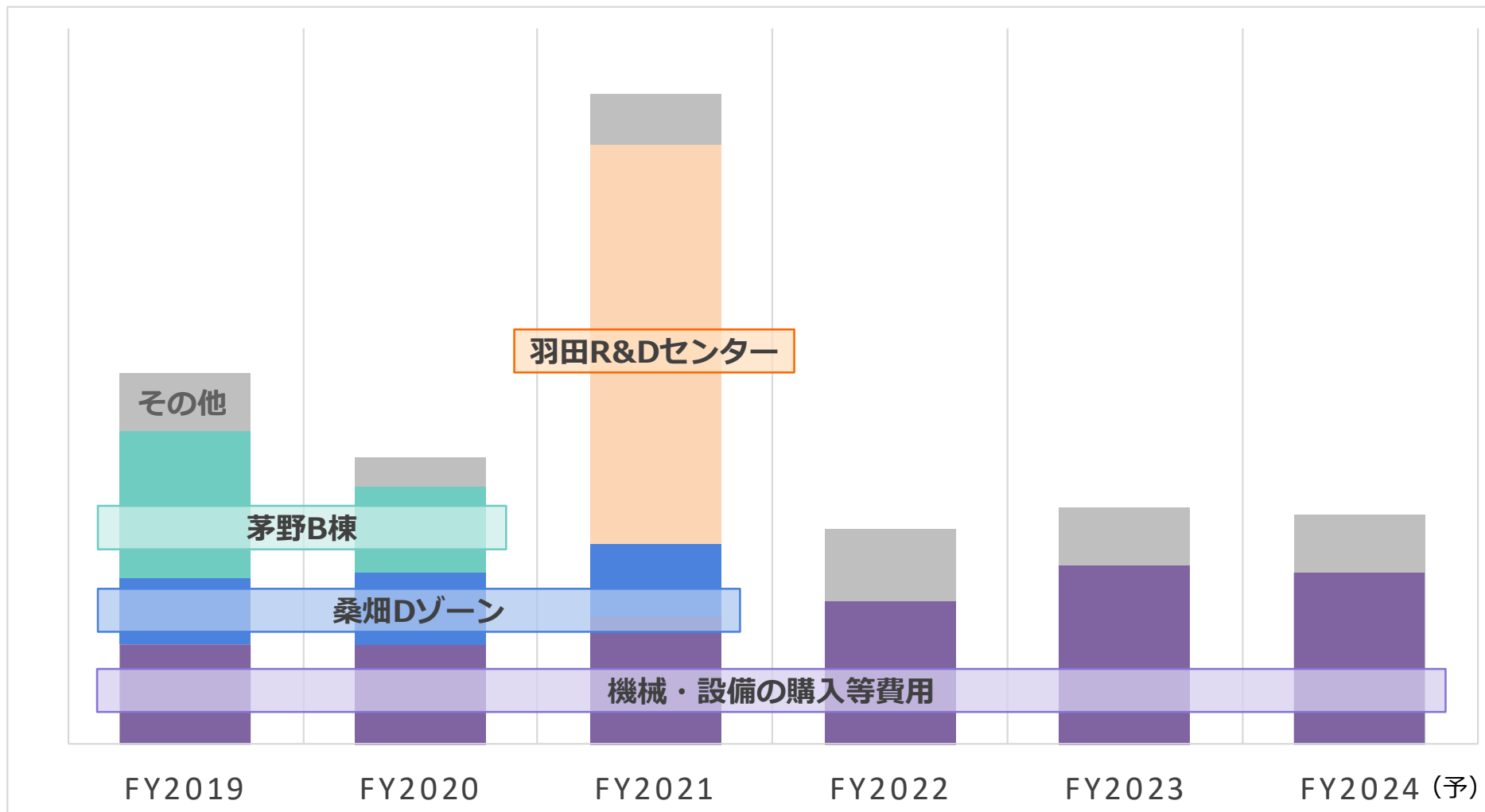
製品群		見通し FY24_1Q 増減率 (QoQ)
	ブレードダイサ	0%
	レーザソー	10%
<b>ダイサ</b>		<b>5%</b>
	薄化DGP	25%
	薄化以外	-25%
<b>グラインダ</b>		<b>0%</b>
<b>周辺装置</b>		<b>30%</b>
<b>精密加工装置</b>		<b>5%</b>
<b>精密加工ツール</b>		<b>-5%</b>
<b>その他</b>		<b>-20%</b>

■ 設備投資      ■ 減価償却      ■ 研究開発

(単位：億円)



**FY24見通し**    設備投資：約160億円    主に合理化投資を実施（羽田R&Dセンター新棟はFY25着工予定）  
                          減価償却：約120億円    前年度と同等か若干増を見込む  
                          研究開発：約290億円    積極的な研究開発を継続

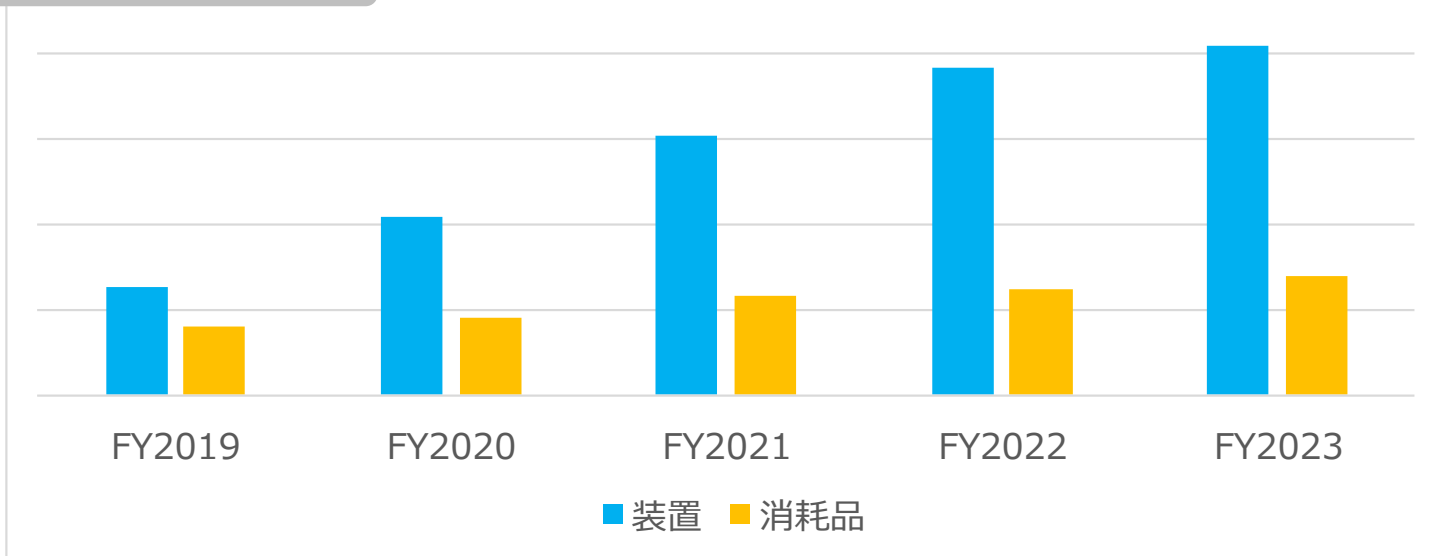


FY24見通し  
 機械・設備の購入等費用 約120億円  
 他 オフィス拡張など 約40億円  
 (羽田R&Dセンター新棟は2025年4月着工予定)

## ■ 出荷動向

1年を通じてP C・スマホ向け需要は低調  
一方でパワー半導体向け出荷が高水準で推移  
加えて生成A I関連の需要が拡大、装置出荷が本格化

出荷額 年間推移

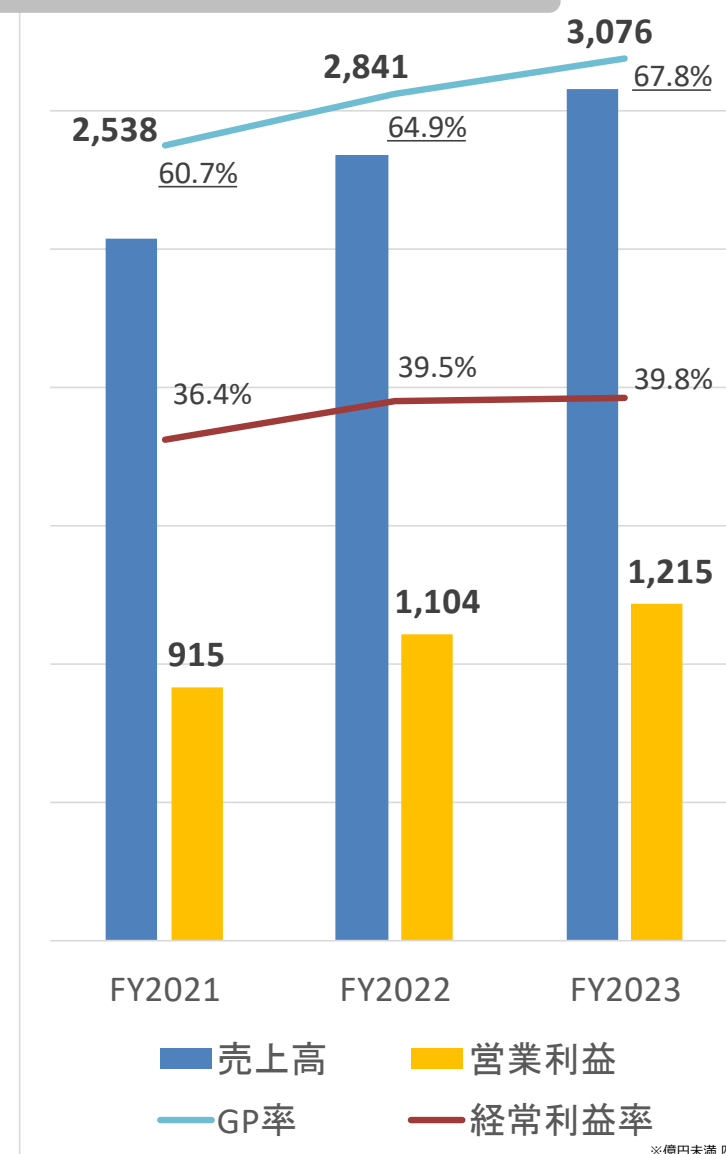


## ■ 収益性の上昇により4期連続最高益

為替追い風と高付加価値製品の貢献でG P率は過去最高

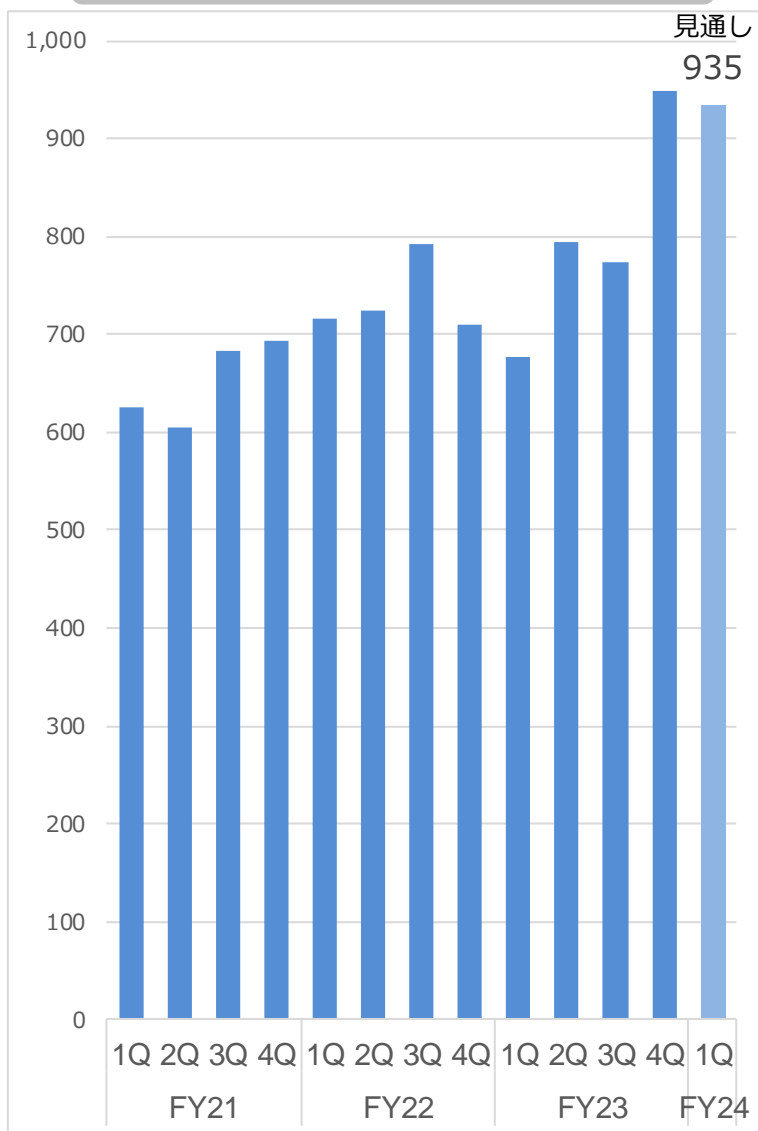
## ■ 人件費増や羽田減損をこなし最高益+余剰資金ふまえ増配 年間配当307円 (前年は約305円※株式分割を考慮)

年間推移 (検収基準) 単位: 億円



※億円未満 四捨五入

出荷額 四半期推移 (単位：億円)



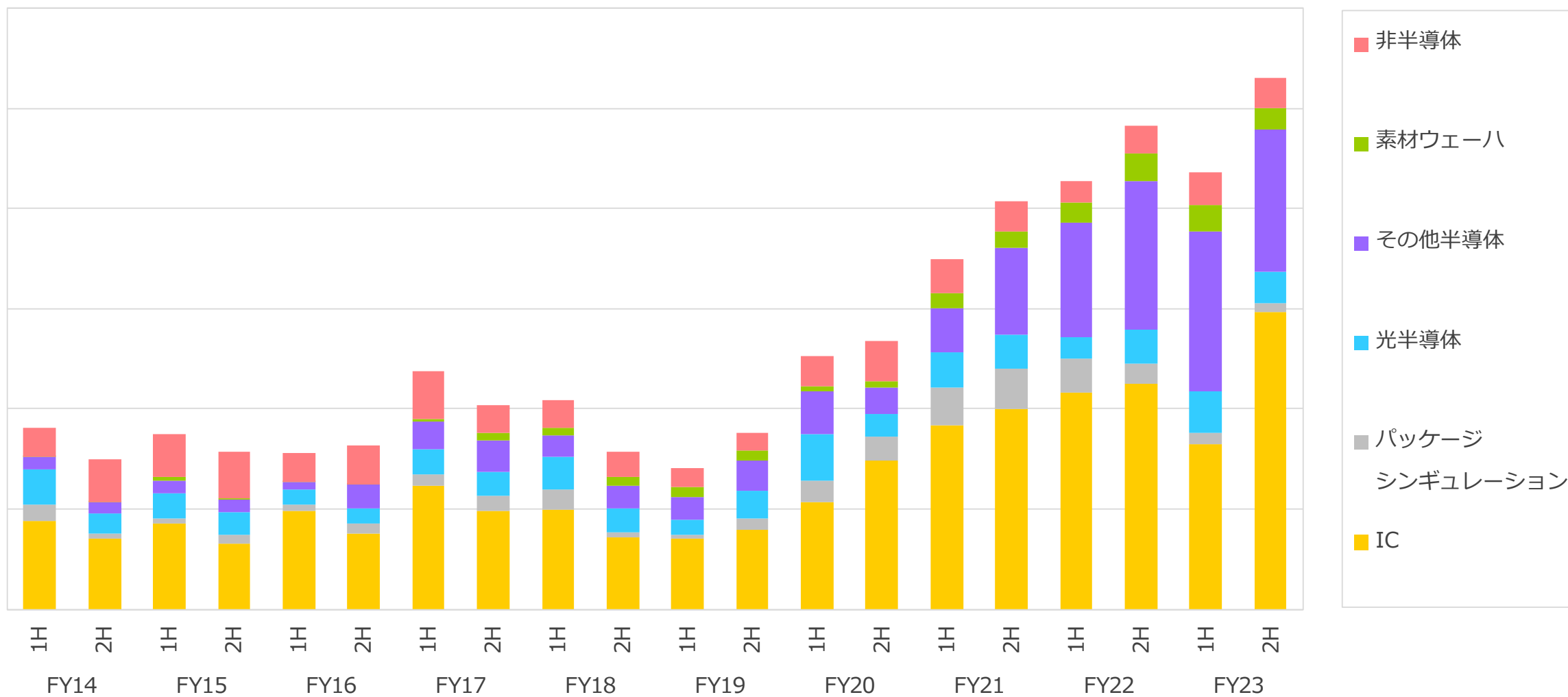
- 生成 A I 関連やパワー半導体向けを中心に高水準の出荷を見込む
- 量産用途 (OSAT、メモリなど) の投資動向は精密加工ツール (消耗品) の動向を含めて注視
- 中長期的な半導体需要増加への対応として生産能力の強化 (用地取得等) や効率化を推進
- 「会社を強くする」取り組みを継続  
DISCO VALUES、Will会計による組織経営とPIM活動を通じた付加価値創出力の強化に引き続き注力
- 高度なKKM技術の開発強化を継続  
羽田R&Dセンター新棟建設 (2025年4月着工予定)  
先端パッケージ技術や自動化など開発テーマの増加に全力で対応中

# 【ご参考】 半期・通期推移 グラフ集

# 精密加工装置 用途別売上高

出荷額ベース

半期

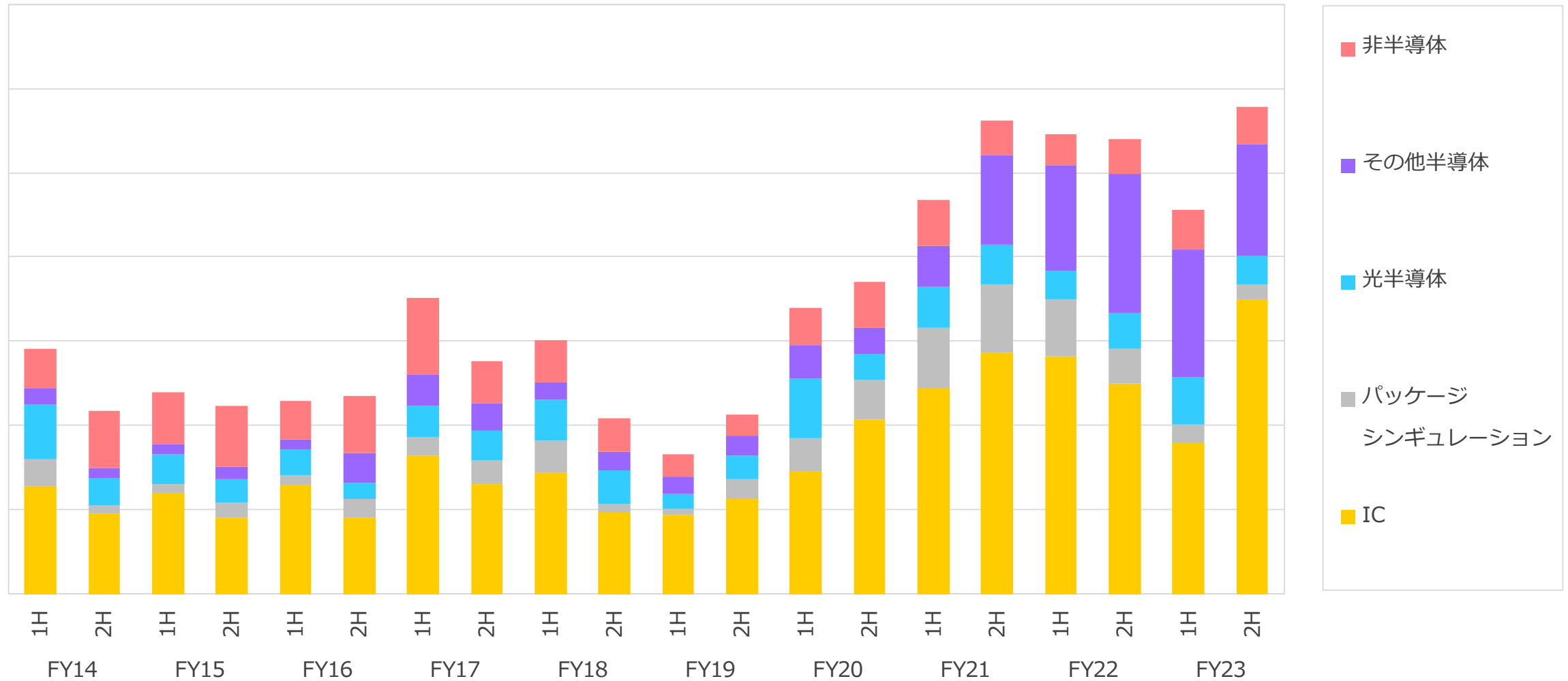




# ダイサ用途別売上高

出荷額ベース

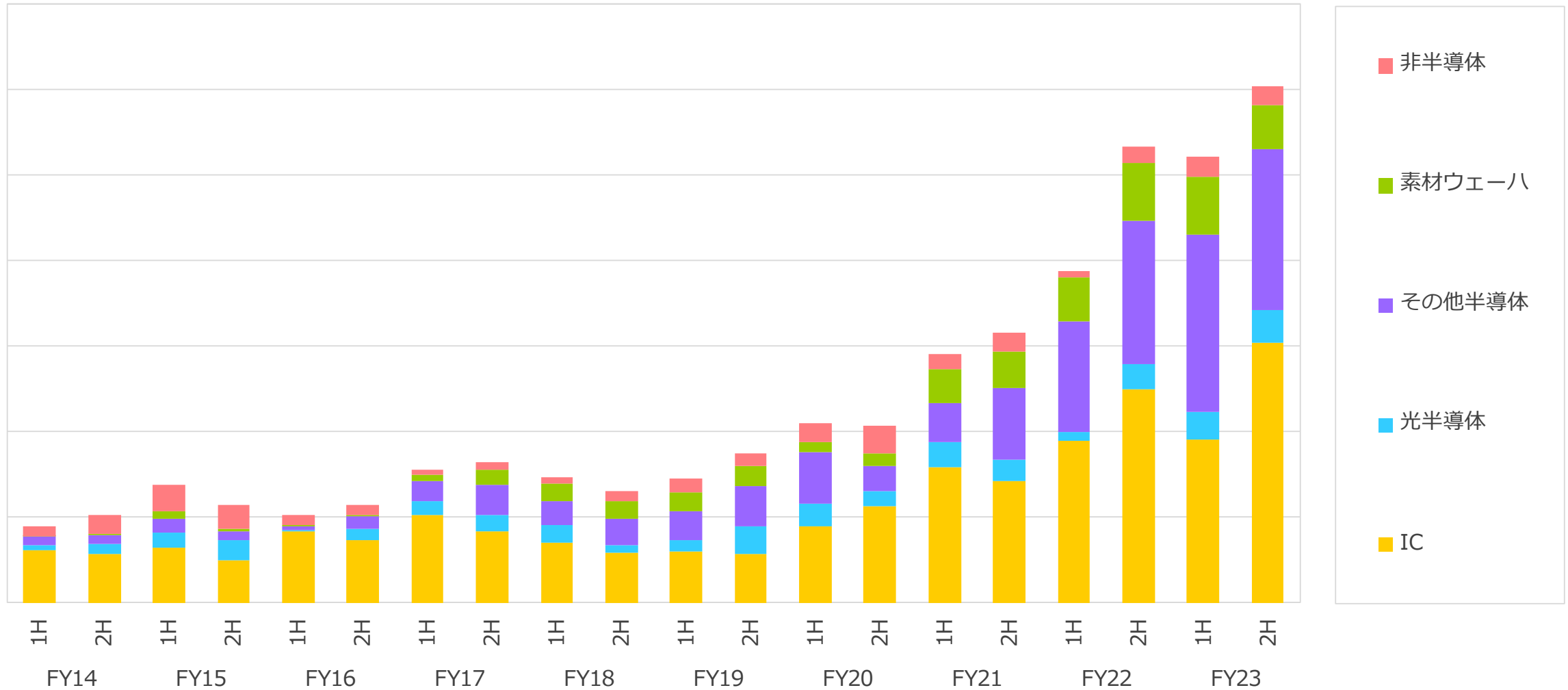
半期



# グライнда用途別売上高

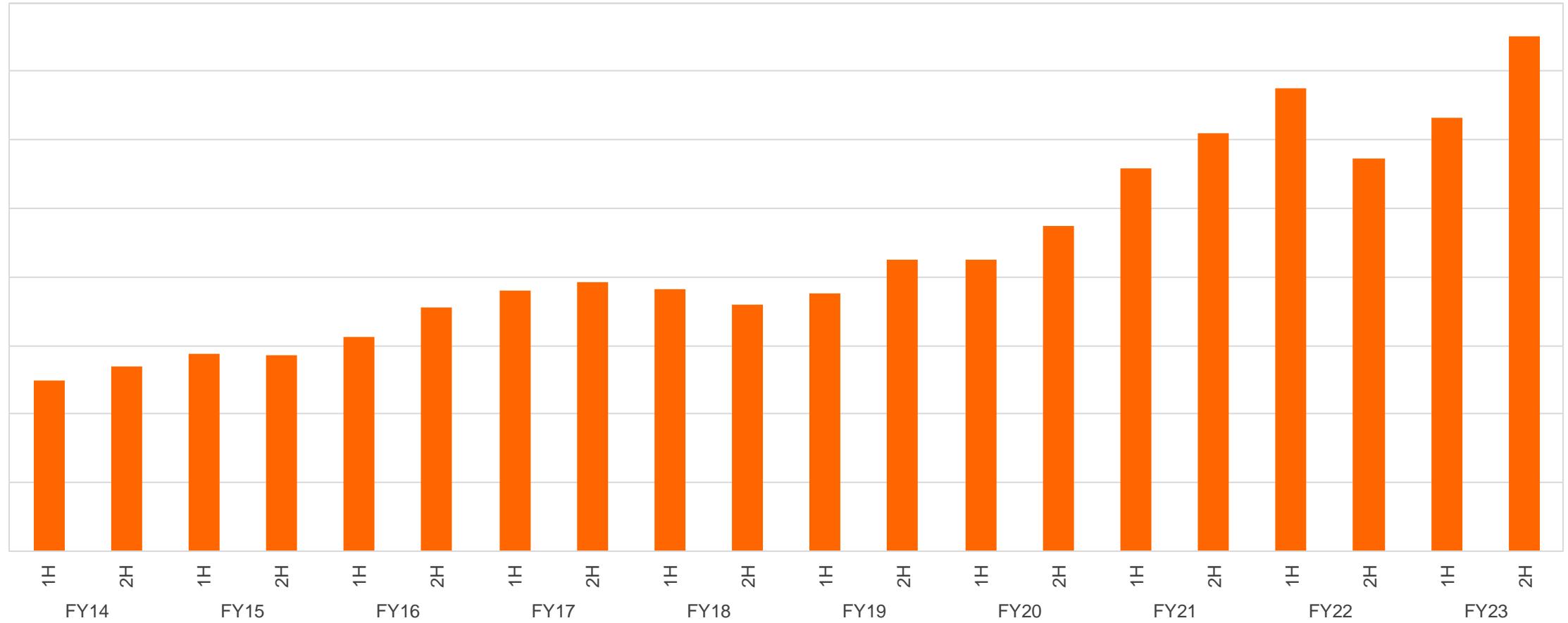
出荷額ベース

半期



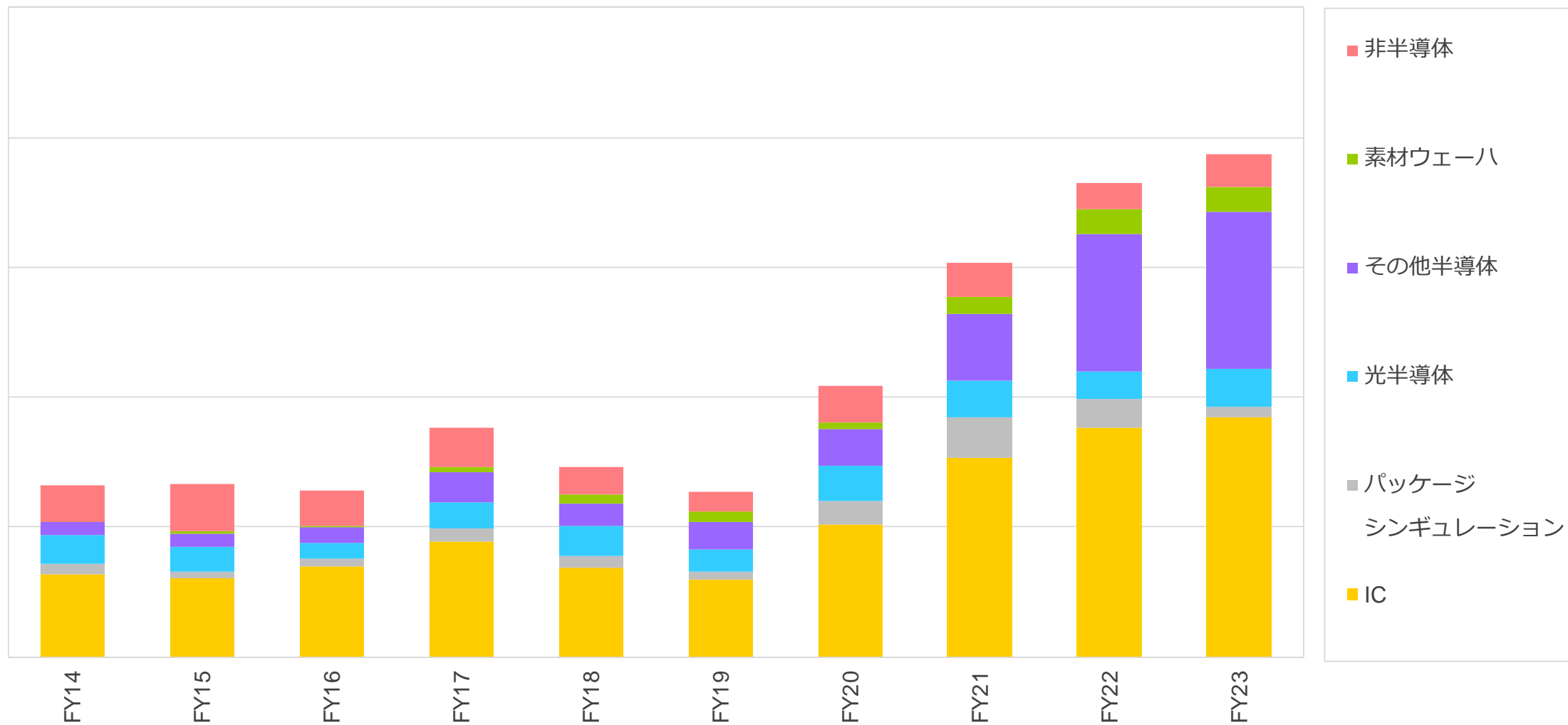
出荷額ベース

半期



出荷額ベース

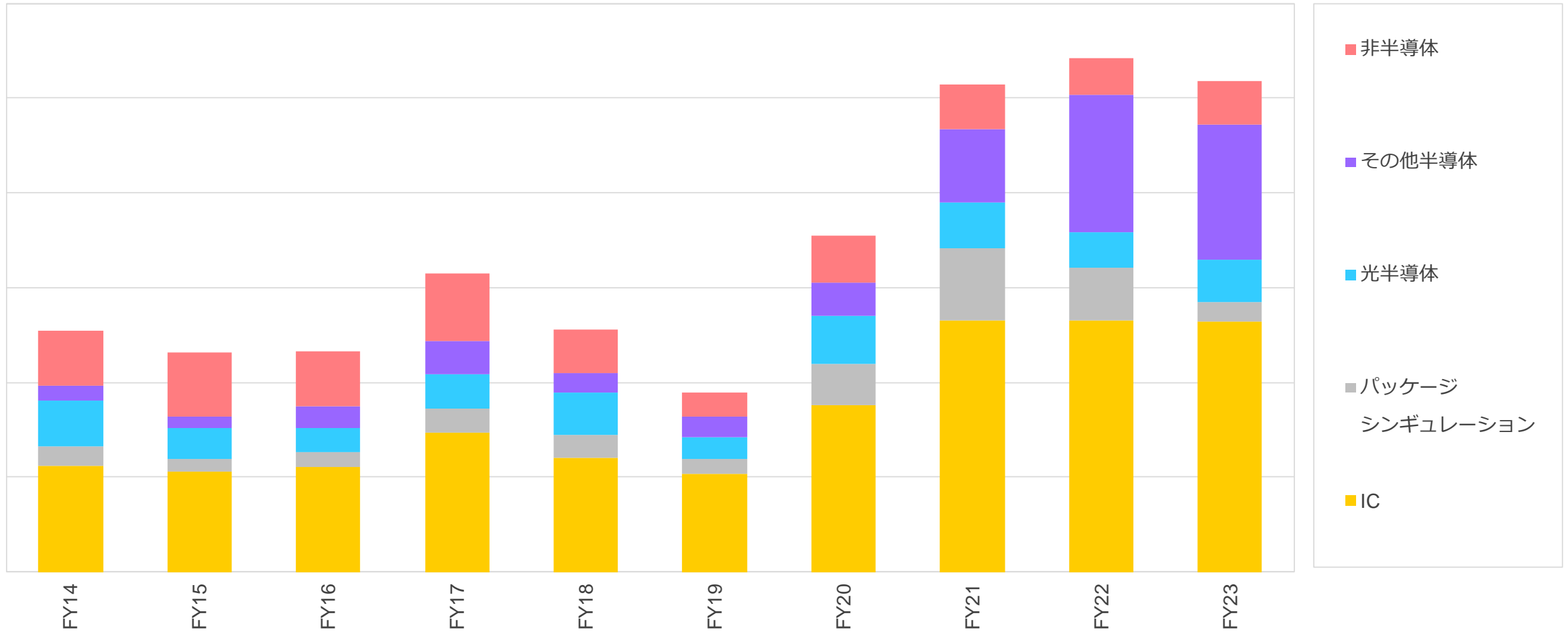
通期



# ダイサ用途別売上高

出荷額ベース

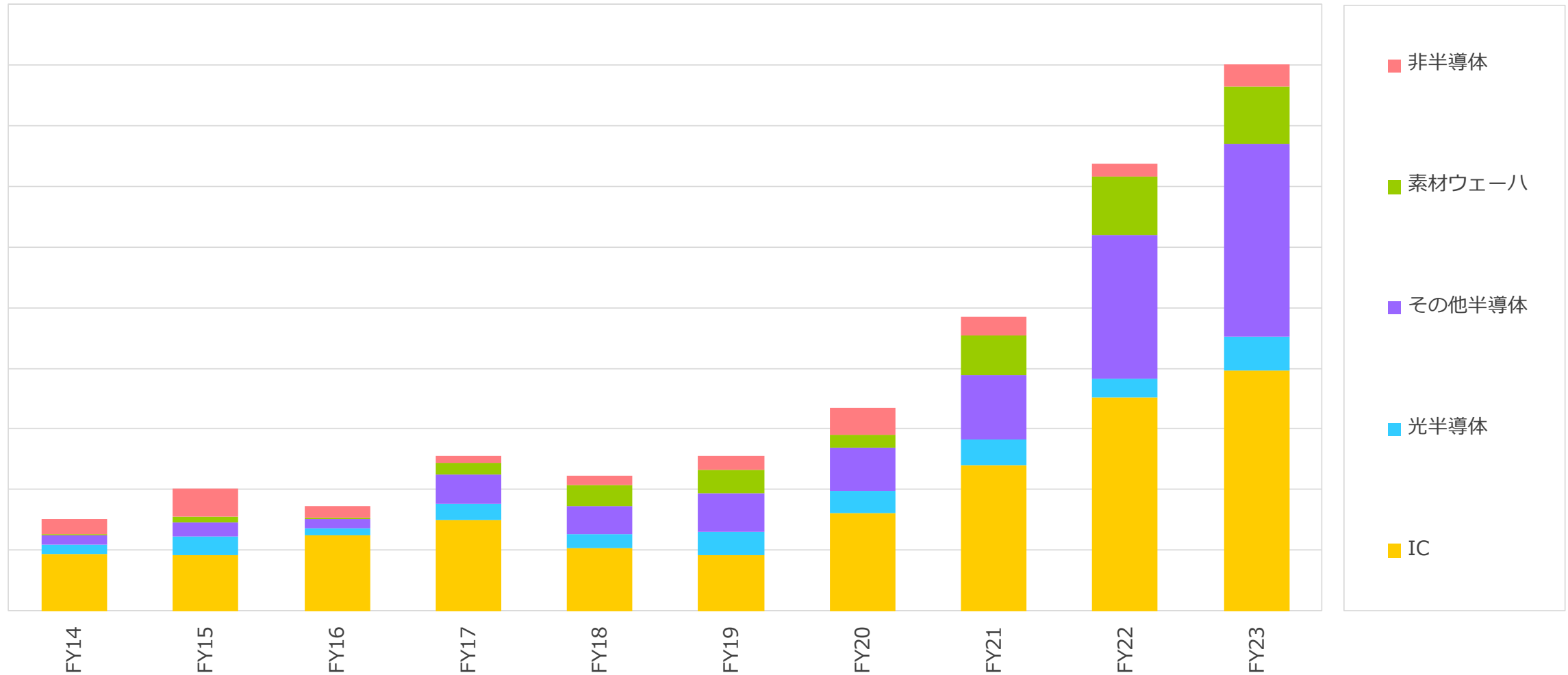
通期



# グライнда用途別売上高

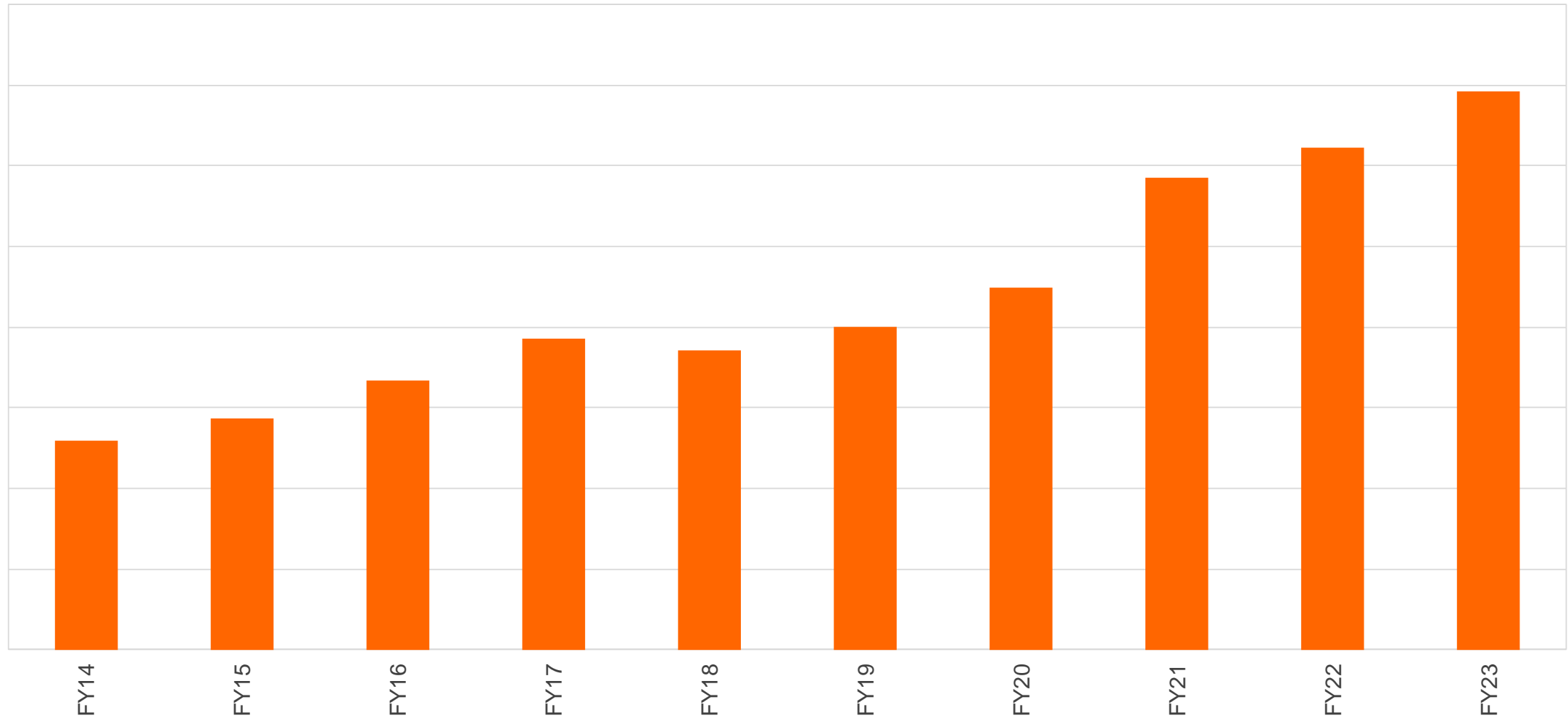
出荷額ベース

通期



出荷額ベース

通期



【ご参考】 製品群別 用途別 データ集



出荷額ベース

■ 製品群	構成比	QoQ	YoY	構成比	YoY	構成比	YoY
	4Q	4Q	4Q	2H	2H	Full Year	Full Year
精密加工装置合計	66%	28%	32%	65%	9%	64%	7%
内、ダイサ	35%	39%	41%	34%	7%	32%	-5%
ブレードダイサ	19%	34%	34%	18%	6%	18%	-10%
レーザー	16%	45%	50%	15%	9%	14%	3%
内、グラインダ	28%	20%	25%	28%	13%	28%	22%
薄化DGP	14%	2%	35%	15%	19%	14%	12%
薄化以外	14%	47%	17%	13%	7%	14%	35%
内、周辺装置	2%	-9%	-4%	3%	-9%	3%	16%
精密加工ツール	20%	6%	48%	22%	31%	22%	11%
その他	14%	30%	26%	14%	21%	14%	13%
出荷額合計	100%	23%	34%	100%	15%	100%	9%

出荷額ベース

製品	用途	FY22				FY23			
		22-1Q	22-2Q	22-3Q	22-4Q	23-1Q	23-2Q	23-3Q	23-4Q
ダイサ	1_IC	53%	51%	48%	44%	38%	40%	60%	61%
	2_パッケージ・シンギュレーション	14%	10%	8%	8%	6%	4%	2%	4%
	3_光半導体	6%	6%	8%	9%	12%	12%	7%	5%
	4_その他_半導体	22%	24%	29%	32%	34%	32%	23%	23%
	5_非半導体	5%	8%	7%	8%	10%	11%	8%	8%
<b>ダイサ</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
グラインダ	1_IC	51%	47%	55%	39%	32%	41%	48%	52%
	2_光半導体	2%	3%	3%	8%	5%	7%	12%	1%
	3_その他_半導体	32%	35%	29%	33%	45%	36%	30%	32%
	4_素材ウエーハ	14%	13%	11%	15%	14%	12%	7%	10%
	5_非半導体	2%	2%	2%	5%	5%	4%	3%	4%
<b>グラインダ</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

出荷額ベース

		FY22				FY23			
製品	用途	22-1Q	22-2Q	22-3Q	22-4Q	23-1Q	23-2Q	23-3Q	23-4Q
ダイサ	1_IC	16%	16%	2%	-27%	-46%	-27%	1%	94%
	2_パッケージ・シングルレシオン	11%	-23%	-47%	-53%	-71%	-60%	-76%	-32%
	3_光半導体	-25%	-38%	-20%	8%	55%	81%	-28%	-18%
	4_その他_半導体	161%	152%	79%	36%	18%	23%	-37%	2%
	5_非半導体	-50%	-9%	87%	-36%	40%	24%	-15%	35%
<b>ダイサ</b>		<b>18%</b>	<b>16%</b>	<b>10%</b>	<b>-17%</b>	<b>-25%</b>	<b>-7%</b>	<b>-19%</b>	<b>41%</b>
グライнда	1_IC	4%	44%	136%	28%	-23%	25%	-11%	69%
	2_光半導体	-71%	-63%	-51%	227%	253%	207%	267%	-81%
	3_その他_半導体	92%	360%	82%	117%	74%	50%	3%	22%
	4_素材ウエーハ	41%	24%	40%	77%	24%	37%	-37%	-15%
	5_非半導体	-62%	-59%	-41%	13%	198%	244%	74%	-4%
<b>グライнда</b>		<b>16%</b>	<b>56%</b>	<b>75%</b>	<b>64%</b>	<b>24%</b>	<b>45%</b>	<b>1%</b>	<b>25%</b>

出荷額ベース

		FY22				FY23			
製品	用途	22-1Q	22-2Q	22-3Q	22-4Q	23-1Q	23-2Q	23-3Q	23-4Q
ダイサ	1_IC	1%	-7%	6%	-27%	-25%	26%	46%	40%
	2_パッケージ・シングルレシオン	3%	-31%	-17%	-20%	-37%	-5%	-50%	126%
	3_光半導体	-15%	4%	36%	-10%	22%	22%	-46%	1%
	4_その他_半導体	8%	8%	36%	-14%	-6%	12%	-30%	39%
	5_非半導体	-51%	55%	-2%	-15%	7%	38%	-33%	36%
<b>ダイサ</b>		<b>-4%</b>	<b>-3%</b>	<b>12%</b>	<b>-21%</b>	<b>-13%</b>	<b>20%</b>	<b>-3%</b>	<b>39%</b>
グラインダ	1_IC	23%	-6%	61%	-31%	-26%	53%	15%	31%
	2_光半導体	-41%	78%	42%	119%	-36%	55%	70%	-89%
	3_その他_半導体	51%	12%	17%	10%	21%	-3%	-20%	30%
	4_素材ウエーハ	22%	-7%	14%	36%	-15%	3%	-48%	85%
	5_非半導体	-71%	-7%	57%	166%	-23%	8%	-21%	46%
<b>グラインダ</b>		<b>20%</b>	<b>1%</b>	<b>39%</b>	<b>-3%</b>	<b>-9%</b>	<b>19%</b>	<b>-3%</b>	<b>20%</b>

検収ベース

■ 構成比

	FY2022				FY2023			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
日本	10%	10%	12%	13%	13%	12%	12%	12%
アメリカ	9%	9%	15%	16%	10%	16%	11%	14%
アジア	73%	73%	66%	62%	67%	63%	66%	65%
シンガポール	11%	10%	10%	9%	8%	9%	7%	6%
台湾	17%	18%	13%	14%	15%	11%	10%	12%
韓国	14%	10%	7%	9%	8%	5%	9%	12%
中国 ※	29%	34%	34%	28%	35%	36%	38%	34%
その他	2%	1%	1%	2%	1%	2%	1%	0%
ヨーロッパ	8%	7%	7%	8%	10%	10%	11%	9%
合計	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

※外資メーカー現地工場向け含む

### 本資料について

掲載内容に関しては細心の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りがあった場合や第三者によるデータの改ざん等に関し、当社は一切責任を負うものではありませんのでご了承ください。また、本資料は投資勧誘を目的にしたものではありません。投資はご自身の判断において行われるようお願いいたします。

### 表記について

年間の会計期間である4月～翌年3月までをFY (Fiscal Year) と表記し、四半期の会計期間は4-6月を1Q、7-9月を2Q、10-12月を3Q、1-3月を4Qと表記しています。金額単位に応じて、単位未満の金額を四捨五入または切り捨て処理しており合計値が合わない場合があります。％は実際の金額を基に算出しています。

### 将来の見通しに関する注意事項

この資料に掲載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実でないものは、将来の業績に関する見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。実際の業績はさまざまな重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を与える重要な要素には世界・日本経済の動向、急激な為替相場の変動ならびに戦争・テロ活動、災害や伝染病の蔓延等があります。

本資料の著作権は当社に帰属しており、無断での転載は禁じられています。私的使用その他法律によって明示的に認められる範囲を超えて、本資料を使用（複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含む）するためには、当社の事前の明示の許諾が必要です。

<https://www.disco.co.jp/>